

インプラントの長所と短所を理解して 補綴プランの提案が重要になる

日時：平成25年5月11日(土)

場所：東京・秋葉原UDX

寄稿

宮川 達也 (東京都)



インプラント技工をする上で

先日、日本インプラント臨床研究会に参加させていただきました。

参加させていただくことになった経緯は2日前にデンツプライ三金社でのフランクフルト大学ネットビック教授によるアンキロス新製品C/Xの紹介に参加した際に同会の若井先生がいらしていました。

アンキロスのインストラクターの福留先生を通じて若井先生との面識がありましたので、若井先生の方から時間があるなら参加しないか？とお誘いがあったので今回の企画に参加させていただきました。

企画の内容は3Iの新製品T3とエンコードの商品

説明にイタリヤからバレンティン先生がいらしていました。

エンコードについては、実際に使用してみないとなんとも言えませんがかなり面白い商品なのかな？と思いました。

若井先生が質問をなさっていましたが、まだこれからの商品。というイメージです。しかし今後の歯科治療の流れは印象採得ではなく、口腔内データーで補綴を製作するのが主流になる時がかなり早い時期にくる気がしました。

T3の商品説明とケースプレゼンテーションについてですが、プラットフォーム、マイクロムーブメントに対してのテーパー結合。それらのメリットとして骨の吸収を防ぎ、歯肉ラインを下げない



で審美的な補綴治療を成功に導く。というものでした。

木曜日にアンキロスのC/Xの製品説明を聞いて、土曜日に3Iの製品説明をきいてしまったので正直な感想では2日とも同じ内容の話が多かった気がします。

数年前に若井先生がインプラント イヤーブックの話をされていましたが、プラットフォームを採用しているメーカーが数社しかいなかったのがいまではかなり多数のメーカーが採用している。

しかし、マイクロムーブメントに話がいく事が無い。と

ですが、今回の3Iもそうですが数か月前に、他



のメーカーのインストラクターの先生もマイクロムーブメントの話をしていました。

数年前はマイノリティーだったため、かなり否定されていたプラットフォームでしたが、今ではスタンダードになっています。

テーパー結合によるマイクロムーブメントの抑制もスタンダードになっていくのではないかと予感させる出来事でした。

今後の補綴物製作に対しての歯科技工士の考え方に、インプラント埋入ポジションが歯肉縁から4ミリ前後深く埋入することが増えてくると思います。

技工作業では埋入深度が深いほうが補綴物のマージン付近の形態を作りやすいですが、当然利点だけではなく、欠点も出てきます。

ですが、インプラント技工をする上でインプラントの長所と短所をわかって補綴プランを歯科医師に提案しながら治療をすすめていく事が今よりももっと重要になっていくと思います。

今回、このような企画に参加させていただいて普段は聞けないような海外の先生のスピーチを聞かせていただきました。

このような機会を与えてくださったCISJに感謝し、また素晴らしい企画にぜひとも参加させていただきたいと思います。

